

IMDS リリース14.1 アプリケーションID 選択肢 英語－日本語対照表

Ver7.0 2023.08.09 by Japan IMDS Committee

本資料に掲載されている日本語訳はあくまでも参考訳です。最終的なご判断の際は、必ず英語原文をご確認下さい。

ID	APPLICATION (英語)	APPLICATION (日本語参考訳)
Lead used as/in		以下の用途や材料中の鉛
69	1(a) – Steel for machining purposes and batch hot dip galvanised steel components containing up to 0.35 % lead by weight	1(a) – 機械加工を目的とした鉄鋼およびバッチ処理溶融亜鉛めっき鉄鋼部品で、0.35重量%以下の鉛を含むもの
70	1(b) – Continuously galvanized steel sheet	1(b) – 0.35重量%以下の鉛を含む連続処理亜鉛めっき鋼板
71	2(a),(b),(c)(i) – Alloying element in aluminum for machining purposes	2(a),(b),(c)(i) – 機械加工を目的としたアルミニウム中の合金成分
72	2(c)(ii) – Recycled aluminum alloy containing unintentionally added lead	2(c)(ii) – 非意図的に鉛が添加されたリサイクルアルミニウム合金
3	3 – Alloying element in copper	3 – 銅中の合金成分
51	4(b) – Alloying element in bearing shells and bushes in engines, transmissions and air conditioning compressors	4(b) – エンジン、トランスミッション、エアコンに使用するベアリングシェルおよびブッシュの合金成分
52	4(a) – Alloying element in bearing shells and bushes for all other applications (potentially prohibited)	4(a) – その他の全ての用途で使用するベアリングシェルおよびブッシュの合金成分(使用禁止の可能性有り)
Lead and its compounds used as/in		以下の用途や材料中の鉛および鉛合金
73	5(a) – Lead in batteries in high voltage systems (2a) that are used only for propulsion in M1 and N1 vehicles	5(a) – M1およびN1車の駆動にのみ使用される高電圧システムのバッテリー中の鉛
85	5(b)(i) – Lead in batteries (1) used in 12 V applications (2) used in 24 V applications in special purpose vehicles as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council	5(b)(i) – (1) 12 V の用途で使用されるバッテリー中の鉛 (2) 欧州議会および理事会の規則 (EU) 2018/858 の第 3 条に定義されている特殊用途車両の 24 V 用途で使用されるバッテリー中の鉛
86	5(b)(ii) – Lead in batteries used in applications not included in entry 5(a) or entry 5(b)(i)	5(b)(ii) – エントリ 5(a) およびエントリ 5(b)(i) に該当しない用途で使用されるバッテリー中の鉛
8	6 – Vibration damper	6 – 制振ダンパ
9	Wheel balance weight	ホイールバランスウエイト
10	7 – Vulcanising agent and stabiliser for elastomers in fluid handling and powertrain applications	7 – 液体取扱用およびパワートレイン部品に使用するエラストマーの加硫剤と安定剤
48	7(c) – Bonding agent for elastomers in powertrain applications	7(c) – パワートレイン部品に使用するエラストマーの接着剤
11	Stabiliser in protective paints	保護塗料中の安定剤
12	Carbon brushes for electric motors	電気モーターカーボンブラシ
53	8(a) – Lead in solder used in electronic circuit board applications	8(a) – 電子基板に電気・電子部品を付けるためのはんだ中の鉛、及び、電解AI キャパシター以外の部品の端子・ピン・電子基板の表面処理中の鉛
54	8(b) – Lead in solders in electrical applications other than soldering on electronic circuit boards or on glass	8(b) – 電子基板上、及び、ガラス上に適用するはんだ以外の電気用途のはんだ中の鉛
55	8(c) – Lead in finishes on terminals of electrolyte aluminium capacitors	8(c) – 電解 AI キャパシターの端子の表面処理中の鉛
56	8(d) – Lead used in soldering on glass in mass airflow sensors	8(d) – マスフローセンサーのガラス上のはんだ中の鉛
57	8(e) – Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead)	8(e) – 高融点のはんだ中の鉛(鉛含有率85wt%以上の鉛合金)
67	8(f)(a) / 8(f)(i) – Lead in compliant pin connector systems	8(f)(a) / 8(f)(i) – コンプライアントピンコネクタシステム中の鉛
68	8(f)(b) / 8(f)(ii) – Lead in compliant pin connector systems other than the mating area of vehicle harness connectors	8(f)(b) / 8(f)(ii) – 車両ハーネス・コネクタの嵌め合い領域以外のコンプライアントピンコネクタシステム中の鉛
75	8(g)(i) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages	8(g)(i) – 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛
76	8(g)(ii-i) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and the carrier within integrated circuit flip chip packages where that electrical connection consists of a semiconductor technology node of 90 nm or larger	8(g)(ii-i) – 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛(90nm半導体テクノロジーノード以上)

77	8(g)(ii-ii) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and the carrier within integrated circuit flip chip packages where that electrical connection consists of a single die of 300 mm ² or larger in any semiconductor technology node	8(g)(ii-ii) – 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛(いずれの半導体テクノロジーノードにおいても300mm ² 以上の単一のダイ)
78	8(g)(ii-iii) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and the carrier within integrated circuit flip chip packages where that electrical connection consists of stacked die packages with dies of 300 mm ² or larger, or silicon interposers of 300 mm ² or larger	8(g)(ii-iii) – 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間における確実な電気接続に必要なはんだに含まれる鉛(300mm ² 以上のダイか300mm ² 以上のシリコンインターポーザーを有する積層ダイパッケージ)
60	8(h) – Lead in solder to attach heat spreaders to the heat sink in power semiconductor assemblies	8(h) – パワーセミコンダクター(チップの突出部分が1cm ² 以上でシリコンチップ部分の比重が1 A/mm ² 以上)のヒートシンクにヒートスプレッダーを装着するはんだ中の鉛
61	8(i) – Lead in solders in electrical glazing applications on glass except for soldering in laminated glazing	8(i) – あわせガラス中のはんだ以外の窓ガラス上の電気用途のはんだ中の鉛
62	8(j) – Lead in solders for soldering of laminated glazing	8(j) – あわせガラス中のはんだ中の鉛
79	8(k) – Soldering of heating applications with 0.5A or more of heat current per related solder joint to single panes of laminated glazings not exceeding wall thickness of 2,1 mm. This exemption does not cover soldering to contacts embedded in the intermediate polymer	8(k) – 合わせガラスに使用されるハンダ(各ガラス層の板厚が2.1mm以下かつハンダ接合部上の電流が0.5A以上)。ただし、中間ポリマーに埋め込まれた接点へのはんだは対象としない。
43	Copper in friction materials of brake linings	ブレーキライニングの摩擦材料中の銅
15	Valve seats	9-バルブシート
63	10(a) – Electrical and electronic components which contain lead in a glass or ceramic, in a glass or ceramic matrix compound, in a glass-ceramic material, or in a glass-ceramic matrix compound. This exemption does not cover the use of lead in: — glass in bulbs and glaze of spark plugs, — dielectric ceramic materials of components listed under 10(b), 10(c) and 10(d).	10(a) – ガラスまたはセラミック、ガラスもしくはセラミックの母材、ガラスセラミック材料またはガラスセラミック母材に鉛を含む電気及び電子構成部品。ただし、以下における鉛の使用は対象としない。-電球のガラス及び点火プラグのガラス質釉薬 -10b)、10c)及び10d)に掲出された構成部品の誘電体セラミック材料
64	10(b) – Lead in PZT based dielectric ceramic materials of capacitors being part of integrated circuits or discrete semiconductors	10(b) – 集積回路又はディスクリート半導体の一部となるコンデンサのPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)誘電体セラミック材料に含まれる鉛
65	10(c) – Lead in dielectric ceramic materials of capacitors with a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC	10(c) – AC125V又はDC250Vより低い定格電圧をもつコンデンサの誘電体セラミック材料に含まれる鉛
66	10(d) – Lead in the dielectric ceramic materials of capacitors compensating the temperature-related deviations of sensors in ultrasonic sonar systems	10(d) – 超音波ソナーシステムのセンサーにおける温度偏差を補正するコンデンサの誘電体セラミック材料に含まれる鉛
17	Glass in bulbs and glaze of spark plugs	電球のガラスおよび点火プラグのガラス質釉薬
44	Concentration within acceptable GADSL limits*1	GADSL で許容されている制限値以下の含有率
20	Other application (potentially prohibited)	その他の用途(使用禁止の可能性有り)
Lead Azide, Lead Styphnate, Lead Dioxide, Lead Dipicrate, Lead Monoxide		アジ化鉛、スチフニン酸鉛、二酸化鉛、ニピクリン酸鉛および一酸化鉛
18	Pyrotechnic initiators	11 – 火工品の起爆剤
Hexavalent chromium and its compounds used as/in		以下の用途や材料中の六価クロムとその化合物
21	13(a) – Corrosion preventive coatings	13(a) – 防食コーティング
49	13(b) – Corrosion preventive coatings related to bolt and nut assemblies for chassis applications	13(b) – シャシ用ボルト・ナットに関連する防食コーティング
80	14(i) – Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilized electrical power input <75W at constant running conditions	14(i) – 一定のランニング条件で75W未満の平均使用電力である電気ヒーターを完全または部分的に設計された吸収式冷凍機の炭素鋼冷却システムの防食剤で、冷却溶液内に重量で0.75%まで含まれる6価クロム
81	14(ii) – Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilized electrical power input ≥75W at constant running conditions	14(ii) – 一定のランニング条件で75W以上の平均使用電力である電気ヒーターを完全または部分的に設計された吸収式冷凍機の炭素鋼冷却システムの防食剤で、冷却溶液内に重量で0.75%まで含まれる6価クロム

82	14(iii) – Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution designed to fully operate with nonelectrical heater	14(iii) – 電気ヒーターなしで完全に設計された吸収式冷凍機の炭素鋼冷却システムの防食剤で、冷却溶液内に重量で0.75%まで含まれる6価クロム
45	Concentration within acceptable GADSL limits*1	GADSL で許容されている制限値以下の含有率
20	Other application (potentially prohibited)	その他の用途（使用禁止の可能性有り）
Mercury used as/in		以下の用途や材料中の水銀
25	15 – Discharge lamps and instrument panel displays	15 – ディスチャージランプおよびインストルメントパネル照明
46	Concentration within acceptable GADSL limits*1	GADSL で許容されている制限値以下の含有率
20	Other application (potentially prohibited)	その他の用途（使用禁止の可能性有り）
Cadmium used as/in		以下の用途や材料中のカドミウム
28	Thick film pastes	厚膜ペースト
29	16 – Batteries for electrical vehicles	16 – 電気自動車用バッテリー
50	Optical component in a glass matrix used for Driver Assistance Systems	ドライバーアシストシステム用ガラス製光学部品
47	Concentration within acceptable GADSL limits*1	GADSL で許容されている制限値以下の含有率
20	Other application (potentially prohibited)	その他の用途（使用禁止の可能性有り）
Nickel used as/in		以下の用途や材料中のニッケル
32	Component of a surface likely to be routinely touched (eg. handles and buckles), that have a nickel release rate exceeding 0.5µg/cm2/week.	日常的に接触する可能性のある部品の表面(例えば、取っ手やバックル) ニッケルの放出率が0.5µg/cm2/week を超える
33	Other application (Surface not routinely touched or nickel release rate < 0.5µg/cm2/week)	その他の用途（表面が日常的に接触しないまたはニッケルの放出率が0.5µg/cm2/week 未満）
34	Not applicable	適用外(上記2例以外)
PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons), excluding 205–99–2 Benz(e)acephenanthrylene 56–55–3 Benz[a]anthracene 50–32–8 Benzo(a)pyrene 192–97–2 Benzo(e)pyrene 205–82–3 Benzo[j]fluoranthene 207–08–9 Benzo[k]fluoranthene 218–01–9 Chrysene 53–70–3 Dibenz[a,h]anthracene		以下の用途や材料中のPAHs（多環芳香族炭化水素類） 適用範囲：PAH物質グループ、ただし、以下を除く 205–99–2 Benz(e)acephenanthrylene 56–55–3 Benz[a]anthracene 50–32–8 Benzo(a)pyrene 192–97–2 Benzo(e)pyrene 205–82–3 Benzo[j]fluoranthene 207–08–9 Benzo[k]fluoranthene 218–01–9 Chrysene 53–70–3 Dibenz[a,h]anthracene
35	The lubricant / oil contains total PAHs >3% according to IP 346	テスト法IP346 による総PAHs含有量が3%を超える潤滑剤/油
36	The lubricant / oil contains total PAHs <3% according to IP 346	テスト法IP346 による総PAHs含有量が3%より少ない潤滑剤/油
37	Extender oil contains PAHs > 10mg/kg (for tyres only)	10mg/kg を超えるPAHs を含む伸展油（タイヤ用途に限る）
38	Extender oil contains PAHs < 10mg/kg (for tyres only)	10mg/kg より少ないPAHs を含む伸展油（タイヤ用途に限る）
39	Non-tyre application	タイヤ以外の利用
PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons), only 205–99–2 Benz(e)acephenanthrylene 56–55–3 Benz[a]anthracene 50–32–8 Benzo(a)pyrene 192–97–2 Benzo(e)pyrene 205–82–3 Benzo[j]fluoranthene 207–08–9 Benzo[k]fluoranthene 218–01–9 Chrysene 53–70–3 Dibenz[a,h]anthracene		以下の用途や材料中のPAHs（多環芳香族炭化水素類） 適用範囲：PAH物質グループ、ただし、以下の物質のみ 205–99–2 Benz(e)acephenanthrylene 56–55–3 Benz[a]anthracene 50–32–8 Benzo(a)pyrene 192–97–2 Benzo(e)pyrene 205–82–3 Benzo[j]fluoranthene 207–08–9 Benzo[k]fluoranthene 218–01–9 Chrysene 53–70–3 Dibenz[a,h]anthracene
83	Repetitive skin contact (required according to REACH 1907/2006 EC Annex XVII Entry 50)	反復的な皮膚接触あり（REACH 1907/2006 EC Annex XVII Entry 50 の規定による）
84	Not applicable (no repetitive skin contact)	適用外(反復的な皮膚接触なし)

*1 Thresholds 0.1% for mercury, lead and hexavalent chromium, 0.01% for cadmium 水銀、鉛、六価クロムは0.1%以下、カドミウムは0.01%以下

変更履歴と解説

Ver 1.1 2005.6.23 新規

Ver 2.0 2005.11.25 EU ELV 指令2000/53/EC のANNEX2の改訂(2005/67/EC)に伴うアプリケーションコード改訂

1) ANNEX2 の項目名変更により、現在のアプリケーションコードの表現を変更する必要がある場合、旧アプリケーションコードは無効(de-acttive)となり新しいアプリケーションコードと入れ替わります。無効化されたアプリケーションコードは、新規に作成されるデータシートに適用できません(表示もされません)。参照されたデータシートが無効化されたアプリケーションコードを含む場合、IMDSは警告を表示します。

ID	無効となるアプリケーションコード	ID	無効のアプリケーションコードと入れ替える アプリケーションコード
Lead used as/in			
4	Alloying element in lead-bronze bearing shells and bushes	42	Alloying element in bearing shells and bushes
Lead and its compounds used as/in			
14	Copper in brake linings	43	Copper in friction materials of brake linings
19	Impurity (not intentionally added)	44	Concentration within acceptable GADSL limits
Hexavalent chromium and its compounds used as/in			
23	Impurity (not intentionally added)	45	Concentration within acceptable GADSL limits
Mercury used as/in			
26	Impurity (not intentionally added)	46	Concentration within acceptable GADSL limits
Cadmium used as/in			
30	Impurity (not intentionally added)	47	Concentration within acceptable GADSL limits

2) 改訂ANNEX2 により新規に追加されたアプリケーションコード

ID	APPLICATION
Lead and its compounds used as/in	
48	Bonding agent for elastomers in powertrain applications
Hexavalent chromium and its compounds used as/in	
49	Corrosion preventive coatings related to bolt and nut assemblies for chassis applications
Cadmium used as/in	
50	Optical component in a glass matrix used for Driver Assistance Systems

Ver 2.1 2007.07.25 英日対照表のID40と41がIMDS上のアプリケーションIDと異なっていたため訂正(本資料のみの訂正であり、システム変更ではありません)

Ver 3.0 2008.10.08 EU ELV 指令2000/53/EC のANNEX2の改訂(2008/689/EC)に伴うアプリケーションコード改訂

1) ANNEX2 の項目名変更により、現在のアプリケーションコードの表現を変更する必要がある場合、旧アプリケーションコードは無効(de-acttive)となり新しいアプリケーションコードと入れ替わります。無効化されたアプリケーションコードは、新規に作成されるデータシートに適用できません(表示もされません)。参照されたデータシートが無効化されたアプリケーションコードを含む場合、IMDSは警告を表示します。

ID	無効となるアプリケーションコード	ID	無効のアプリケーションコードと入れ替える アプリケーションコード
Lead used as/in			
42	Alloying element in bearing shells and bushes	51	Alloying element in bearing shells and bushes in engines, transmissions and air conditioning compressors.
		52	Alloying element in bearing shells and bushes for all other applications (potentially prohibited).

Ver 4.0 2010.06.03 EU ELV 指令2000/53/EC のANNEX2の改訂(2010/115/EU)に伴うアプリケーションコード改訂
ANNEX2の改訂により、新規アプリケーションコードを追加

ID	APPLICATION
53	Lead in solder used in electronic circuit board applications – 8a)
54	Lead in solders in electrical applications other than soldering on electronic circuit boards or on glass – 8b)
55	Lead in finishes on terminals of electrolyte aluminium capacitors – 8c)
56	Lead used in soldering on glass in mass airflow sensors – 8d)
57	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead) – 8e)
58	Lead in compliant pin connector systems – 8f)
59	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages – 8g)
60	Lead in solder to attach heat spreaders to the heat sink in power semiconductor assemblies – 8h)
61	Lead in solders in electrical glazing applications on glass except for soldering in laminated glazing – 8i)
62	Lead in solders for soldering in laminated glazing – 8j)

Ver 5.0 2011.09.16 EU ELV 指令2000/53/EC のANNEX2の改訂(2011/37/EU)に伴うアプリケーションコード改訂

1) ANNEX2の改訂により、以下の新規アプリケーションコードを追加

ID	APPLICATION
63	10(a) – Electrical and electronic components which contain lead in a glass or ceramic, in a glass or ceramic matrix compound, in a glass-ceramic material, or in a glass-ceramic matrix compound. This exemption does not cover the use of lead in: — glass in bulbs and glaze of spark plugs, — dielectric ceramic materials of components listed under 10(b), 10(c) and 10(d).
64	10(b) – Lead in PZT based dielectric ceramic materials of capacitors being part of integrated circuits or discrete semiconductors
65	10(c) – Lead in dielectric ceramic materials of capacitors with a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC
66	10(d) – Lead in the dielectric ceramic materials of capacitors compensating the temperature-related deviations of sensors in ultrasonic sonar systems

2)以下のアプリケーションコードを隠し属性に変更(アジアのサプライヤーからのご要望により、前回2010年11月の更新から今までは有効となっていました)

ID	APPLICATION
13	Solder in electronic circuit boards and other electric applications

Ver 6.0 アプリケーションコード改訂

1) 以下のアプリケーションコードを隠し属性に変更(2012.1.31)

ID	APPLICATION
16	Electrical components which contain lead in a glass or ceramic matrix compound except glass in bulbs and glaze of spark plugs

2) 以下のアプリケーションコードを変更(2016.6.14)

ID	無効となるアプリケーションコード	ID	無効のアプリケーションコードと入れ替える アプリケーションコード
Lead used as/in			
58	Lead in compliant pin connector systems – 8f)	67	8f) (a) – Lead in compliant pin connector systems
		68	8f) (b) – Lead in compliant pin connector systems other than the mating area of vehicle harness connectors

Ver 6.1 以下のアプリケーションコードを隠し属性から無効に変更

ID	APPLICATION
13	Solder in electronic circuit boards and other electric applications
16	Electrical components which contain lead in a glass or ceramic matrix compound except glass in bulbs and glaze of spark plugs

Ver 6.2 以下のアプリケーションコードを変更(2018.12.5)

ID	隠し属性となるアプリケーションコード	ID	隠し属性のアプリケーションコードと入れ替える アプリケーションコード
Lead used as/in			
1	1 – Alloying element in steel for machining purposes or galvanised steel	69	1(a) – Steel for machining purposes and batch hot dip galvanised steel components containing up to 0.35 % lead by weight
		70	1(b) – Continuously galvanized steel sheet
2	2 – Alloying element in aluminium for machining purposes	71	2(a),(b),(c)(i) – Alloying element in aluminum for machining purposes
		72	2(c)(ii) – Recycled aluminum alloy containing unintentionally added lead
Lead and its compounds used as/in			
7	5 – Battery	73	5(a) – Lead in batteries in high voltage systems (2a) that are used only for propulsion in M1 and N1 vehicles
		74	5(b) – Lead in batteries for battery applications not included in entry 5(a)

Ver 6.3 アプリケーションコードの追加および変更(2020.6.17)

以下のアプリケーションコードを追加

ID	APPLICATION
79	8(k) – Soldering of heating applications with 0,5A or more of heat current per related solder joint to single panes of laminated glazings not exceeding wall thickness of 2,1 mm. This exemption does not cover soldering to contacts embedded in the intermediate polymer

以下のアプリケーションコードを変更

ID	無効となるアプリケーションコード	ID	無効のアプリケーションコードと入れ替える アプリケーションコード
Lead and its compounds used as/in			
59	8(g) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages	75	8(g)(i) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages
		76	8(g)(ii-i) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and the carrier within integrated circuit flip chip packages where that electrical connection consists of a semiconductor technology node of 90 nm or larger
		77	8(g)(ii-ii) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and the carrier within integrated circuit flip chip packages where that electrical connection consists of a single die of 300 mm ² or larger in any

			semiconductor technology node
		78	8(g)(ii-iii) – Lead in solders to complete a viable electrical connection between the semiconductor die and the carrier within integrated circuit flip chip packages where that electrical connection consists of stacked die packages with dies of 300 mm ² or larger, or silicon interposers of 300 mm ² or larger
	Hexavalent chromium and its compounds used as/in		
22	14 – Absorption refrigerators in motorcaravans	80	14(i) – Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilized electrical power input <75W at constant running conditions
		81	14(ii) – Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution designed to operate fully or partly with electrical heater, having an average utilized electrical power input ≥75W at constant running conditions
		82	14(iii) – Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0.75% by weight in the cooling solution designed to fully operate with nonelectrical heater

Ver 6.4 アプリケーションコードの追加および変更(2021.7.21)

以下のアプリケーションコードを隠し属性に

40	Not applicable	適用外(上記6例以外)
41	PAH in lubricating oil	潤滑油中のPAH(多環芳香族炭化水素)

以下のアプリケーションコードを追加

83	Repetitive skin contact (required according to REACH 1907/2006 EC Annex XVII Entry 50)	反復的な皮膚接触あり (REACH 1907/2006 EC Annex XVII Entry 50 の規定による)
84	Not applicable (no repetitive skin contact)	適用外(反復的な皮膚接触なし)

以下の物質はアプリケーションコードの入力を要求されなくなります

83-32-9 Acenaphthene
208-96-8 Acenaphthylene
120-12-7 Anthracene
191-24-2 Benzo(ghi)perylene
206-44-0 Fluoranthene
86-73-7 Fluorene
193-39-5 Indeno[1,2,3-cd] pyrene
1321-94-4 Methylanthralene
91-20-3 Naphthalene
85-01-8 Phenanthrene
129-00-0 Pyrene

Ver 6.5 アプリケーションコードの変更(2022.4.27)

以下のアプリケーションコードを隠し属性から無効に変更

40	Not applicable	適用外(上記6例以外) ※6例とはID35-39,41を示す
41	PAH in lubricating oil	潤滑油中のPAH(多環芳香族炭化水素)

Ver 7.0 アプリケーションコードの変更(2023.8.9)

2023.03.30 EU ELV 指令2000/53/EC のANNEX II の改訂 (2023/544 /EU)に伴うアプリケーションコード改訂

(1) 以下のアプリケーションコードを隠し属性に変更

74	5(b) – Lead in batteries for battery applications not included in entry 5(a)	5(b) – 5(a)に該当しないバッテリー用途のために使用されるバッテリー中の鉛
----	--	---

(2) 以下のアプリケーションコードを追加

ID	APPLICATION
85	5(b)(i) – Lead in batteries (1) used in 12 V applications (2) used in 24 V applications in special purpose vehicles as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council
86	5(b)(ii) – Lead in batteries used in applications not included in entry 5(a) or entry 5(b)(i)

(3) 以下のアプリケーションコードの名称を変更

ID	APPLICATION (旧)	APPLICATION (新)
67	8(f)(a) – Lead in compliant pin connector systems	8(f)(a) / 8(f)(i) – Lead in compliant pin connector systems
68	8(f)(b) – Lead in compliant pin connector systems other than the mating area of vehicle harness connectors	8(f)(b) / 8(f)(ii) – Lead in compliant pin connector systems other than the mating area of vehicle harness connectors